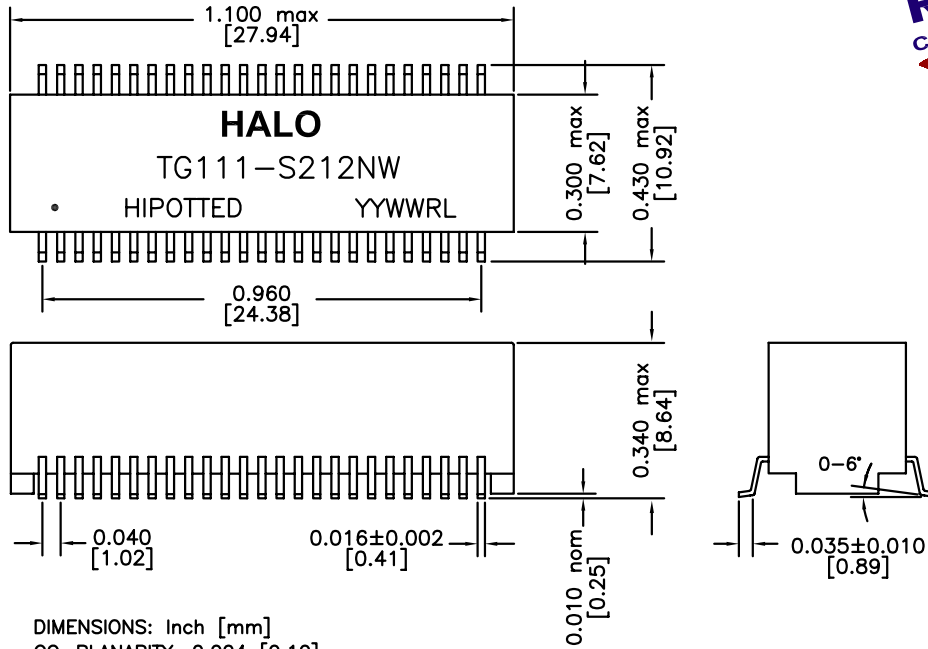


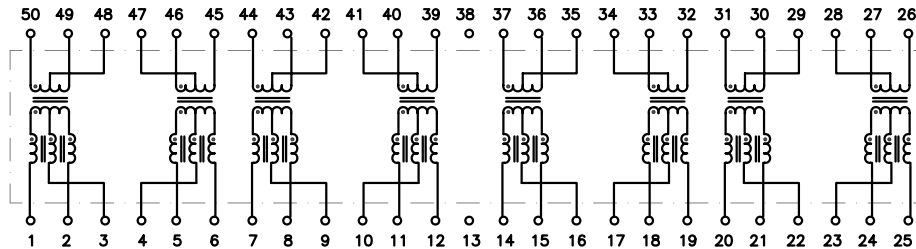


PART NO. : TG111-S212NWRL

50PIN 0.040" LEAD PITCH SMT PACKAGE
 DESIGNED FOR DUAL-PORT GIGABIT, IEEE802.3ab OR
 FOUR-PORT FAST ETHERNET, IEEE802.3u APPLICATIONS
 COMPLIANT WITH IEEE802.3af REQUIREMENTS WITH
 350mA CURRENT CARRYING CAPACITY FOR PoE
 RoHS COMPLIANT
 COMPATIBLE TO LEAD-FREE SOLDERING PROCESS
 CONDITION PER IPC/JEDEC J-STD-020C
 UL/EN60950 AND DEMKO RECOGNIZED
 OPERATING TEMPERATURE 0/70°C



DIMENSIONS: Inch [mm]
 CO-PLANARITY: 0.004 [0.10]
 TOLERANCES: ±0.005 INCH IF NOT SPECIFIED



ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25° C

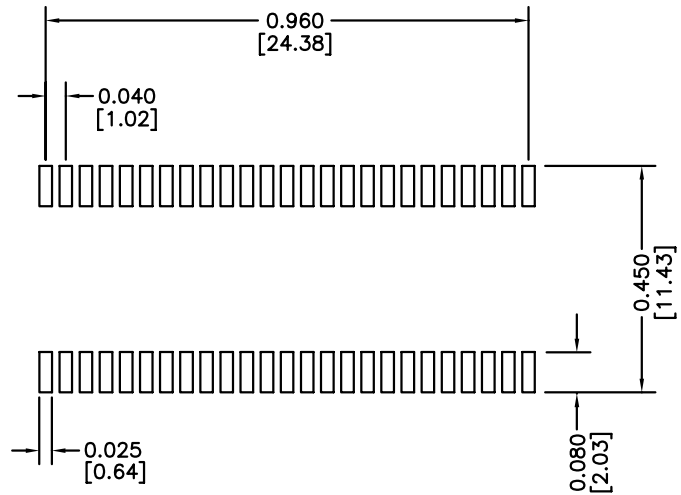
| | |
|-------------------------------|------------|
| URNS RATIO | 1CT:1CT±2% |
| OCL (100KHz,0.1Vrms,8mADC) | 350µH min |
| INSERTION LOSS 1-100MHz | -1.1dB max |
| RETURN LOSS 1-40MHz | -18dB min |
| 60MHz | -14dB min |
| 80MHz | -12dB min |
| 100MHz | -10dB min |
| CMR 1-100MHz | -40dB typ |
| CROSSTALK 1-30MHz | -50dB typ |
| 60MHz | -45dB typ |
| 100MHz | -40dB typ |
| ISOLATION | 1,500Vrms |



HALO/PBL

CALIFORNIA, USA
 KOWLOON, HONG KONG
 SINGAPORE

| | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------|----------------------|----------|
| TITLE | ISOLATION MODULE | | SIGNATURES | DATE | REV. | DESC. | DATE |
| | FOR | FAST/GIGABIT ETHERNET | DRAWN PETER LU | 11/8/05 | A | FIRST ISSUE | 11/8/05 |
| | PART NO. | TG111-S212NWRL | CHECKED LEI KEONG | 3/20/08 | B | PROD. RELEASE | 12/21/06 |
| | SCALE | NONE | APPROVED PETER LU | 3/20/08 | C | REV. TOE LENGTH TOL. | 3/20/08 |
| | PAGE | 1 OF 2 | FILE | S212NWRL.DWG | | | |



RECOMMENDED SOLDER PAD DIMENSIONS
 DIMENSIONS: Inch [mm]

HALO/PBL

CALIFORNIA, USA
 KOWLOON, HONG KONG
 SINGAPORE

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------|------|----------------------|----------|
| TITLE | ISOLATION MODULE | | SIGNATURES | DATE | REV. | DESC. | DATE |
| FOR | FAST/GIGABIT ETHERNET | | DRAWN PETER LU | 11/8/05 | A | FIRST ISSUE | 11/8/05 |
| PART NO. | TG111-S212NWRL | | CHECKED LEI KEONG | 3/20/08 | B | PROD. RELEASE | 12/21/06 |
| SCALE | NONE | PAGE 2 OF 2 | APPROVED PETER LU | 3/20/08 | C | REV. TOE LENGTH TOL. | 3/20/08 |
| FILE | S212NWRL.DWG | | | | | | |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.